



HOCHFREQUENZ LEITERPLATTEN (DUROIDE)

■ Montage

Materialien:

- ARLON AR 1000/AD 1000
- Rogers RT/duroid-Laminate
- Rogers RO 3000er, 4000er Serie
- Rogers ULTRALAM
- Rogers TMM
- Flexboard-Material (z.B. Pyralux)
- Taconic RF-35, RF-60, CER-10, TLC-30
- Andere

Abmessungen:

- Mit Dukos/Multilayer: max. 9"x12"
- Ohne Dukos: max. 10"x16"

■ Leiterbahnen

Materialien:

- Cu

Dicken:

- Standard: 17,5 µm bzw. 35 µm, 70 µm und andere

Oberflächen:

- Chem. Ni + Au (löt- und bondfähig)
- Galv. Au (bondfähig)
- Chem Sn (lötfähig)
- Organische Kupferpassivierung
- Alpha Level
- Ni/Pd/Au
- HAL

Leiterbahnbreite & Abstände:

- Min. 50 µm, ± 10 µm
- Standard: 200 µm, ± 30 µm

■ Technologische Möglichkeiten

- Herstellung von Multilayern aus unterschiedlichen Materialien (z.B. RO 3003/FR4)
- Laminierung von Polymersubstraten auf metallischen Trägerplatten (z.B. Wärmesenken)
- Laserbearbeitung (Sacklöcher, Mikrovias, Cavities)
- Montage zu kompletten Baugruppen inklusive elektrischer Tests

■ Lieferzeit für Prototypen

10 Arbeitstage nach Vorliegen der Maskendaten inklusive Masken, Schichtherstellung und Montage von Bauelementen